

超配（维持）

半导体行业双周报（2026/04/27-2026/05/10）

云厂商继续上调资本开支

2026年5月11日

刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：

liumenglin@dgzq.com.cn

投资要点：

- **半导体行业指数近两周涨跌幅：**截至2026年5月10日，申万半导体行业指数近两周（2026/04/27-2026/05/10）累计上涨13.67%，跑赢沪深300指数11.52个百分点；2026年以来申万半导体行业指数累计上涨34.04%，跑赢沪深300指数28.82个百分点。
- **行业新闻与公司动态：**（1）机构：2026年全球九大CSP资本支出上调至8300亿美元；（2）存储三巨头押注DRAM新技术，或打开两类接口芯片空间；（3）AMD苏姿丰：CPU地位正不断抬升，AMD已进入新一轮高增长通道；（4）美光科技：245TB容量的美光6600 ION SSD现已出货；（5）AMD苏姿丰：有信心2027年实现数据中心人工智能业务年营收数百亿美元；（6）AMD苏姿丰：预计第二季度服务器CPU营收同比增长超70% 2027年将持续强劲增长；（7）AMD：将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元，推理与智能体AI应用正加速提升服务器CPU算力需求；（8）AMD：预计到2030年CPU市场年增长超过35%；（9）千问PC端上线AI语音输入功能；（10）鼎龙股份：先进封装用TSV等三类抛光液产品取得重大进展并获得订单 其中氧化铈CMP抛光液获得国内龙头存储芯片企业批量订单。
- **周报观点：**据SIA，2026年3月全球半导体销售额同比+79.2%，国内半导体销售额同比+74.8%，环比增长12.7%。2026年1-3月，全球半导体销售额合计同比+62.51%，国内半导体销售额合计同比+59.88%，显示AI需求驱动下行业景气度持续提升，CPU、存储、算力芯片等核心环节持续紧缺。资本开支方面，字节跳动拟将2026年AI相关资本开支上调约25%，反映国内互联网大厂对AI需求增长预期持续提升。当前，AI算力投资正逐步由阶段性建设转向长期基础设施化，GPU、HBM、高速交换芯片、电源管理及先进封装等环节有望持续受益。与上一轮云计算周期相比，本轮AI Capex在持续扩张训练集群的同时，推理侧需求占比亦明显提升，“而Agent、多模态及长上下文应用普及亦有望进一步提升Token消耗与推理负载，推动算力需求持续增长。
- **风险提示：**成本上升导致终端需求不及预期的风险、国产替代进程不及预期的风险、产能持续释放导致竞争加剧的风险等。

半导体行业（申万）指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

相关报告

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。

请务必阅读末页声明。

目录

1. 半导体行业行情回顾	3
2. 半导体产业新闻	3
3. 公司公告与动态	5
4. 半导体产业数据更新	5
4.1 智能手机出货数据	5
4.2 新能源汽车销售数据	6
4.3 全球、国内半导体月度销售数据	6
5. 投资建议	7
6. 风险提示	7

插图目录

图 1：半导体行业 2021 年初至今行情走势（截至 2026 年 5 月 10 日）	3
图 2：全球智能手机季度出货量	6
图 3：国内智能手机月度出货情况	6
图 4：新能源汽车销量及同比增长率	6
图 5：国内新能源汽车销量及渗透率	6
图 6：全球半导体月度销售情况	6
图 7：中国半导体月度销售情况	6

1. 半导体行业行情回顾

半导体行业指数近两周涨跌幅：截至 2026 年 5 月 10 日，申万半导体行业指数近两周（2026/04/27-2026/05/10）累计上涨 13.67%，跑赢沪深 300 指数 11.52 个百分点；2026 年以来申万半导体行业指数累计上涨 34.04%，跑赢沪深 300 指数 28.82 个百分点。

图 1：半导体行业 2021 年初至今行情走势（截至 2026 年 5 月 10 日）



资料来源：iFind，东莞证券研究所

2. 半导体产业新闻

1. 【机构：2026 年全球九大 CSP 资本支出上调至 8300 亿美元】

财联社 5 月 6 日电，根据 TrendForce 集邦咨询最新 AI 产业研究，由于多数北美主要云端服务供应商 (CSP) 近日再度上修 2026 年资本支出指引，以回应强劲的 AI 需求，TrendForce 集邦咨询上调全年美系 Google（谷歌）、AWS（亚马逊云科技）、Meta、Microsoft（微软）、Oracle（甲骨文）以及中系 ByteDance（字节跳动）、Tencent（腾讯）、Alibaba（阿里巴巴）、Baidu（百度）等九大 CSP，合计资本支出预估至约 8,300 亿美元，年增率也从原本的 61% 提升至 79%。

2. 【存储三巨头押注 DRAM 新技术 或打开两类接口芯片空间】

财联社 5 月 6 日电，服务器 DRAM 模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会 (JEDEC) 的成员包括三星电子、SK 海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发 MRDIMM 产品，以满足未来不断增长的需求。有别于 HBM 与 GPU 集成，MRDIMM 将用作 CPU 直接访问的主内存。作为新一代服务器 DRAM 模块，其专为人工智能和高性能计算 (HPC) 任务而优化，能够同时运行两个内存通道，因此可提供更快的数据处理速度。

3. 【AMD 苏姿丰：CPU 地位正不断抬升 AMD 已进入新一轮高增长通道】

财联社 5 月 6 日电，AMD（超威半导体）董事会主席兼首席执行官苏姿丰在 2026 年第一季度财报电话会上表示，AI 推理与智能体应用正重塑算力结构，CPU 地位正不断抬升，AMD 已进入新一轮高增长通道。

4. 【美光科技：245TB 容量的美光 6600 ION SSD 现已出货】

财联社 5 月 6 日电，美光科技近日宣布，正式出货 245TB 容量的美光 6600 ION SSD。美光 245TB 6600 ION SSD 专为支持人工智能（AI）、云计算、企业级及超大规模工作负载而设计，可满足下一代 AI 数据湖、云端规模文件与对象存储等场景需求。

5. 【AMD 苏姿丰：有信心 2027 年实现数据中心人工智能业务年营收数百亿美元】

财联社 5 月 6 日电，AMD（超威半导体）董事会主席兼首席执行官苏姿丰在 2026 年第一季度财报电话会上表示，展望未来，凭借领先性能、内存带宽与横向扩展能力，客户对赫利俄斯平台需求极为旺盛。赫利俄斯平台开发进展顺利，芯片、软件与系统均按关键节点高效推进。我们已向核心客户送样 MI450 系列图形处理器，按计划于今年下半年启动赫利俄斯平台量产出货。临近量产阶段，MI450 系列图形处理器需求持续走强，核心客户需求预测已超我们初始计划，越来越多新客户洽谈大规模部署，包括额外的多吉瓦级合作机会。基于这一扩大的需求可见度，我们愈发有信心，2027 年实现数据中心人工智能业务年营收数百亿美元，未来数年超越 80% 以上的长期增长目标。

6. 【AMD 苏姿丰：预计第二季度服务器 CPU 营收同比增长超 70% 2027 年将持续强劲增长】

财联社 5 月 6 日电，AMD（超威半导体）董事会主席兼首席执行官苏姿丰在 2026 年第一季度财报电话会上表示，预计第二季度服务器中央处理器营收同比增长超 70%，并在 2026 年下半年至 2027 年随着下一代霄龙处理器量产而持续强劲增长。

7. 【AMD：将 2030 年服务器市场规模预期从 600 亿美元上调至 1200 亿美元 推理与智能体 AI 应用正加速提升服务器 CPU 算力需求】

财联社 5 月 6 日电，美东时间周二盘后，AMD 管理层在财报电话会上表示，AMD 预计未来几年服务器中央处理器（CPU）总潜在市场年复合增长率超 35%，并将 2030 年市场规模预期从去年预测的 600 亿美元翻倍上调至 1200 亿美元。AMD CEO 苏姿丰表示：“我们所预判的智能体人工智能、推理及各类中央处理器算力需求，正在以更快的速度成为现实……各大云服务商与企业客户的中央处理器需求均大幅提升。”

8. 【AMD：预计到 2030 年 CPU 市场年增长超过 35%】

财联社 5 月 6 日电，AMD 表示，预计到 2030 年，CPU 市场年增长超过 35%；预计公司第二季度 CPU 收入增长超过 70%；Meta 芯片的出货预计将于下半年如期启动；由于内存和零部件成本上涨，公司预计下半年 PC 出货量将有所下降；公司正与供应

链合作伙伴“紧密合作”，以增加晶圆和后端生产能力。

9. 【AMD 第二季度预计营收 109 亿美元至 115 亿美元 市场预估 105.2 亿美元】

财联社 5 月 6 日电，AMD 一季度调整后净利润 22.65 亿美元，IBES 预期 21.14 亿美元；一季度净利润 13.83 亿美元。公司预计第二季度营收 109 亿美元至 115 亿美元，市场预估 105.2 亿美元。

10. 【千问 PC 端上线 AI 语音输入功能】

财联社 5 月 7 日电，财联社记者从阿里方面获悉，今日千问在 PC 端上线 AI 语音输入功能，用户通过快捷键可在各类桌面应用中直接使用。千问语音输入法支持对口语内容去语气词、纠错、格式化整理等，能够基于上下文智能回复，还可直接下达创作、问答、翻译等指令。目前，千问语音输入法功能已经全面开放，用户可通过千问 PC 端免费使用。在钉钉、微信或邮件等场景，用户也可要求千问根据上下文自动生成回复。

3. 公司公告与动态

1. 【鼎龙股份：先进封装用 TSV 等三类抛光液产品取得重大进展并获得订单 其中氧化铈 CMP 抛光液获得国内龙头存储芯片企业批量订单】

财联社 5 月 6 日电，鼎龙股份(300054.SZ)公告称，公司控股子公司—武汉鼎泽新材料技术有限公司，近期在半导体 CMP 抛光液领域接连取得三项重大进展，分别在大硅片精抛液、氧化铈抛光液、先进封装用 TSV 抛光液领域实现产品突破并获得客户订单。其中氧化铈 CMP 抛光液产品近期成功通过国内龙头存储芯片制造企业的全流程验证，获得客户批量订单，正式进入规模化供应阶段。大硅片精抛液、氧化铈抛光液、先进封装用 TSV 抛光液领域在国内的市场规模合计超 10 亿元，目前国产化率极低。公司本次实现多类抛光液产品突破，进一步补齐国内高端 CMP 抛光液供给短板，更好响应国内多类核心客户端抛光液本土化供应需求。

4. 半导体产业数据更新

4.1 智能手机出货数据

全球智能手机出货数据：根据 IDC 数据，2026 年第一季度全球智能手机出货量为 2.90 亿台，同比下降 4.99%，环比下降 13.86%；2025 年全球智能手机总出货量为 12.59 亿台，同比增长 1.75%。

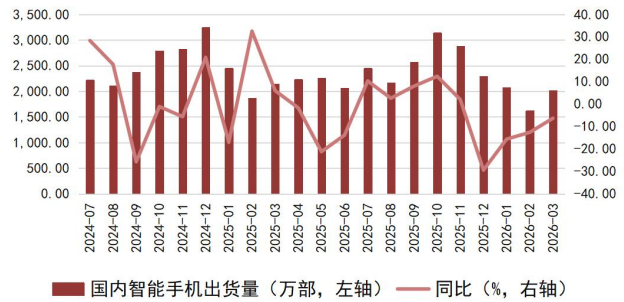
国内智能手机出货数据：根据工信部数据，2026 年 3 月国内智能手机出货量为 2,008.70 万台，同比下降 6.30%，环比增长 23.55%。2026 年 1-3 月国内智能手机累计出货量为 3,634.5 万台，同比下降 9.22%。

图 2：全球智能手机季度出货量



资料来源：IDC，东莞证券研究所

图 3：国内智能手机月度出货情况

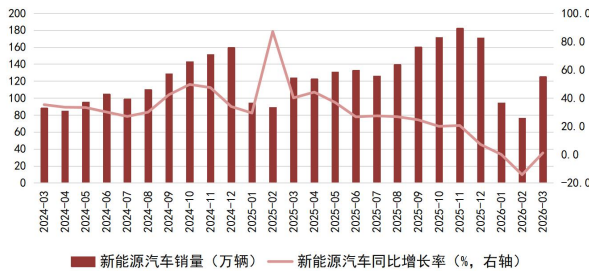


资料来源：工信部，东莞证券研究所

4.2 新能源汽车销售数据

新能源汽车销售数据：据中汽协，2026 年 3 月，国内新能源汽车总销量为 125.2 万辆，同比增长 1.2%，环比增长 63.66%，2026 年 3 月国内汽车总销量为 289.9 万台，其中新能源汽车销量占比为 43.19%。

图 4：新能源汽车销量及同比增长率



资料来源：中汽协，东莞证券研究所

图 5：国内新能源汽车销量及渗透率



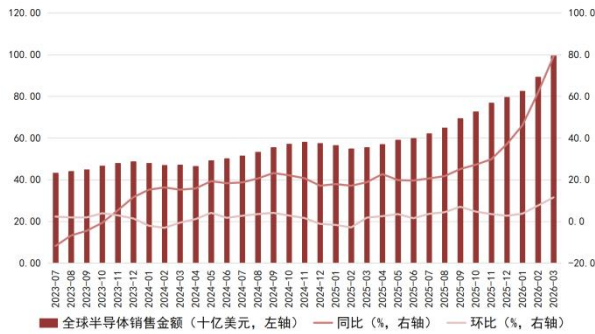
资料来源：中汽协，东莞证券研究所

4.3 全球、国内半导体月度销售数据

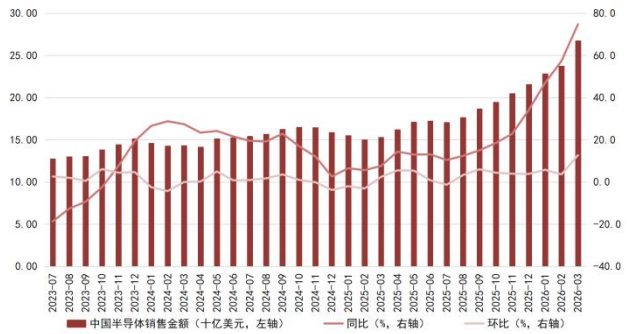
全球、中国半导体销售数据：根据美国半导体产业协会（SIA）数据，2026 年 3 月，全球半导体销售额为 995.2 亿美元，同比增长 79.2%，环比增长 11.5%，国内半导体销售额为 267.4 亿美元，同比增长 74.8%，环比增长 12.7%。2026 年 1-3 月，全球半导体销售额合计为 2712.9 亿美元，同比增长 62.51%，国内半导体销售额合计为 732.9 亿美元，同比增长 59.88%。

图 6：全球半导体月度销售情况

图 7：中国半导体月度销售情况



资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所



资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

5. 投资建议

据 SIA, 2026 年 3 月全球半导体销售额同比+79.2%，国内半导体销售额同比+74.8%，环比增长 12.7%。2026 年 1-3 月，全球半导体销售额合计同比+62.51%，国内半导体销售额合计同比+59.88%，显示 AI 需求驱动下行业景气度持续提升，CPU、存储、算力芯片等核心环节持续紧缺。资本开支方面，字节跳动拟将 2026 年 AI 相关资本开支上调约 25%，反映国内互联网大厂对 AI 需求增长预期持续提升。当前，AI 算力投资正逐步由阶段性建设转向长期基础设施化，GPU、HBM、高速交换芯片、电源管理及先进封装等环节有望持续受益。与上一轮云计算周期相比，本轮 AI Capex 在持续扩张训练集群的同时，推理侧需求占比亦明显提升，“而 Agent、多模态及长上下文应用普及亦有望进一步提升 Token 消耗与推理负载，推动算力需求持续增长。

建议关注标的：

- **半导体设备与材料：**北方华创(002371)、中微公司(688012)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、精智达(688627)、鼎龙股份(300054)、江丰电子(300666)；
- **存储芯片：**兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、佰维存储(688525)、德明利(001309)；
- **模拟芯片：**圣邦股份(300661)、思瑞浦(688536)；
- **先进封装与测试：**长电科技(600584)、通富微电(002156)、伟测科技(688372)；
- **SoC 与 CIS：**恒玄科技(688608)、思特威(688213)、瑞芯微(603893)；
- **算力芯片：**海光信息(688041)
- **晶圆代工：**中芯国际(688981)

6. 风险提示

成本上升导致终端需求不及预期的风险、国产替代不及预期的风险、价格竞争加剧的风险等。

东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，导致无法给出明确的投资评级；股票不在常规研究覆盖范围之内

行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明：本评级体系的“市场指数”，A股参照标的为沪深 300 指数；新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告，市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板（含退市整理期）等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告，港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系：“保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报，“谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报，“稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报，“积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报，“激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券股份有限公司为全国综合性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22115843

网址：www.dgzq.com.cn